

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	2026年4月20日 百年保险资管、贝莱德、大成基金、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、金鹰基金、诺安基金、鹏华基金、银河基金等
时间	2026年4月20日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长、首席执行官、总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多

	<p>个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。</p> <p>为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。</p> <p>基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。</p> <p>2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司如何看待未来互联网厂商 ASIC 业务需求？</p> <p>回复：近年来，互联网公司、云服务提供商、车企等系统厂商因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因多寻求与芯片设计服务公司进行合作。</p> <p>芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、</p>

互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之一。2025 年，芯原系统级客户（非芯片设计公司）所产生的收入占比约 40%，且连续 5 年保持在 30%以上。

问题： 请问公司如何看待业绩增长的趋势？

回复：根据公司《关于新签订单的自愿性披露公告》，2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，公司新签订单 45.16 亿元，继 2025 年第二、第三、第四季度新签订单三次突破历史新高后（分别为 11.82 亿元、15.93 亿元、27.11 亿元），继续保持强劲的增长态势，为公司未来营业收入增长提供有力的保障。

2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，公司新签订单中绝大部分为 ASIC 业务订单，AI 算力相关订单占比超 85%，数据处理领域订单占比 84.77%且主要来自于云侧 AI ASIC 及 IP。

问题：海内外算力硬件需求持续增长，公司在这个领域有哪些技术优势和业务积累？

回复：因算法较为复杂和需要进行海量数据处理，AIGC 模型在云侧进行训练和推理，以及在端侧进行微调和推理时，产生了很大的算力需求。AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正在成为高效 AI 计算的刚需选项，尤其在超大规模数据中心、实时边缘推理及车载系统领域增长迅速。

作为“AI ASIC 龙头企业”，芯原在云端算力（训练和推理）芯片定制领域已建立起显著优势；面向未来，公司将在持续服务数据中心、高性能计算等市场需求的同时，大力拓展端侧 AI 市场，为端侧 AI 微调和推理提供高效的算力支持。2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，公司新签订单 45.16 亿元，其中 AI 算力相关订单占比超 85%，预计未来 AI 算力相关领

域的客户需求将驱动公司业绩增长。

问题： 请问公司在 FD-SOI 领域有哪些布局？

回复： FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用，公司已深入布局 FD-SOI 技术多年。目前，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 45 个客户授权了 300 多个/次 FD-SOIP 核；并已经为国内外知名客户提供了 43 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 33 个项目已经进入量产。公司将继续基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。